

杭州士兰微电子股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：

厦门士兰明镓化合物半导体有限公司（以下简称“士兰明镓”）。士兰明镓为杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）之控股子公司。

● 本次预计担保金额及已实际为其提供的担保余额：

公司于 2025 年 5 月 29 日签署了《保证合同变更协议》，按最新持股比例调整对士兰明镓 9.5 亿元中长期贷款所提供的担保比例，即担保比例从 30% 变更为 56.5638%，对应的担保额度从不超过 2.85 亿元变更为不超过 5.374 亿元。

截至本公告披露日，公司为士兰明镓实际提供的担保余额为 5.78 亿元，担保余额在公司相关股东大会批准的担保额度范围内。

● 本次担保无反担保。

● 本公司不存在逾期对外担保。

● 特别风险提示：

被担保人士兰明镓最近一期经审计的资产负债率为 70.86%，敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

（一）担保进展情况

公司于 2025 年 5 月 29 日与国家开发银行厦门市分行（以下简称“国开行厦门分行”）签署了 1 份《保证合同变更协议》，公司按最新持股比例调整对控股子公司士兰明镓在国开行厦门分行的 9.5 亿元中长期贷款所提供的担保比例，即担保比例从 30% 变更为 56.5638%，对应的担保额度从不超过 2.85 亿元变更为不超过 5.374 亿元，担保方式和担保期限不变，具体如下：

担保合同名称	保证人	被担保人 (借款人)	债权人 (贷款人)	变更前的担保比例及担保金额	变更后的担保比例及担保金额	担保方式	担保期限
保证合同变更协议	杭州士兰微电子股份有限公司	厦门士兰明镓化合物半导体有限公司	国家开发银行厦门市分行	公司就被担保债务的30%向贷款人提供担保,即担保的债权额为人民币2.85亿元及其利息、费用等	公司就被担保债务的56.5638%向贷款人提供担保,即担保的债权额为人民币5.374亿元及其利息、费用等	连带责任保证担保	主合同项下债务履行期届满之日起三年

上述担保中,士兰明镓的另一股东厦门半导体投资集团有限公司的相关方按25.2986%的持股比例同时提供连带责任保证担保。

上述担保无反担保。上述担保非关联担保。

(二) 本次担保事项履行的内部决策程序

公司于2025年4月23日召开的第八届董事会第三十三次会议和2025年5月9日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整士兰明镓担保额度的议案》,同意公司为士兰明镓在国开行厦门分行9.5亿元中长期贷款提供担保的比例从30%调整到56.5638%,对应的担保额度从不超过2.85亿元调整到不超过5.374亿元,担保方式和担保期限不变。股东大会同时授权董事长陈向东先生签署具体的担保协议及相关法律文件。具体内容详见公司于2025年4月24日和2025年5月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告,公告编号为临2025-016、临2025-017和临2025-022。

本次担保在上述股东大会批准的担保额度范围内,无须另行召开董事会及股东大会审议。

(三) 截至本公告披露日,公司为士兰明镓实际提供的担保余额为5.78亿元,其中为上述担保实际提供的担保余额为3.55亿元(本次担保比例调整后),担保余额在公司相关股东大会批准的担保额度范围内。

二、被担保人基本情况

(一) 被担保人士兰明镓的基本情况

公司名称	厦门士兰明镓化合物半导体有限公司
统一社会信用代码	91350200MA31GA8D5D
成立日期	2018年2月1日
注册地址	厦门市海沧区兰英路99号

法定代表人	陈向东
注册资本	2,460,382,891.96元（已足额缴纳）
企业类型	其他有限责任公司
主营业务	化合物半导体芯片制造
经营期限	2018年2月1日至2068年1月31日
股权结构	杭州士兰微电子股份有限公司持有56.5638% 厦门半导体投资集团有限公司持有25.2986% 国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司持有14.1070% 厦门海创发展股权投资合伙企业（有限合伙）持有4.0306%
资信状况	士兰明镓未被列为失信被执行人，不存在影响偿债能力的重大或有事项

（二）士兰明镓最近一年及一期的主要财务数据如下：

（单位：人民币 万元）

项 目	2025年3月末/2025年1-3月 （未经审计）	2024年末/2024年度 （经审计）
资产总额	381,822	399,244
负债总额	277,217	282,913
净资产	104,605	116,331
营业收入	19,167	93,374
净利润	-11,726	-38,427
资产负债率	72.60%	70.86%

三、担保协议的主要内容

担保合同名称	保证人	被担保人 （借款人）	债权人 （贷款人）	变更前的担保比例及担保金额	变更后的担保比例及担保金额	担保方式	担保期限
保证合同变更协议	杭州士兰微电子股份有限公司	厦门士兰明镓化合物半导体有限公司	国家开发银行厦门市分行	公司就被担保债务的30%向贷款人提供担保，即担保的债权额为人民币2.85亿元及其利息、费用等	公司就被担保债务的56.5638%向贷款人提供担保，即担保的债权额为人民币5.374亿元及其利息、费用等	连带责任保证担保	主合同项下债务履行期届满之日起三年

上述担保无反担保。上述担保非关联担保。

四、担保的必要性和合理性

士兰明镓为本公司与厦门半导体投资集团有限公司根据《关于化合物半导体项目之投资合作协议》共同投资设立的项目公司，其系专业从事化合物半导体芯片制造的企业，目前主要为公司制造LED芯片和6吋SiC芯片。本次担保事项

是由于公司在士兰明镓的持股比例增加而相应增加在原有担保事项中的担保比例。被担保人士兰明镓正通过技术改造和效率提升，改善经营效益，预计 2025 年度士兰明镓 LED 芯片和 SiC 芯片出货量将显著增加。士兰明镓目前资信状况良好，具备偿债能力。

士兰明镓为公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，能够及时掌握其资信状况和履约能力，担保风险处于公司可控范围内，不会对公司正常经营活动产生重大影响。

本次担保事项符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

公司于 2025 年 4 月 23 日召开的第八届董事会第三十三次会议和 2025 年 5 月 9 日召开的 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整士兰明镓担保额度的议案》。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日和 2025 年 5 月 10 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告，公告编号为临 2025-016、临 2025-017 和临 2025-022。

六、累计对外担保数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司批准对外担保总额为 51.658 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 42.29%，其中：公司对控股子公司提供的担保总额为 42.374 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 34.69%；公司为参股公司厦门士兰集科微电子有限公司提供的担保总额为 9.284 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 7.60%。公司及控股子公司均无逾期的对外担保事项。（注：担保总额包含已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和）

特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 31 日